证券代码：001309　　证券简称：德明利　　公告编号：2025-030

深圳市德明利技术股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

☑是 □否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以161770306为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德明利	股票代码	001309
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	于海燕	李格格	
办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2401	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋2401	
传真	0755-23572708	0755-23572708	
电话	0755-23579117	0755-23579117	
电子信箱	dml.bod@twsc.com.cn	dml.bod@twsc.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业，专注于存储控制芯片与解决方案的创新研发。自设立以来，公司的主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。公司经过多年积累，形成了自主可控的主控芯片研发核心技术。同时，公司拥有固件解决方案以及量产优化工具核心技术。在此基础上，结合产品方案设计、存储模组测试、供应链管理和产品生命周期管理，构建了完善的存储解决方案，高效实现存储颗粒的数据管理和应用性能提升，为客户创造长期价值，共同成长。

公司从芯片底层算法开发到终端应用适配，从供应链管理到产品全生命周期支持，向客户提供一站式、全链路存储解决方案。公司产品线涵盖固态硬盘、嵌入式存储、内存条及移动存储四大系列，已广泛应用于车载电子、数据中心、新能源汽车、手机、平板、安防监控等多元应用场景。基于存储介质研究，固件开发平台、自研测试装备和算法软件，公司存储产品实现晶圆颗粒与特定应用场景的敏捷适配，保障数据存储的稳定性、安全性和兼容性，持续为全球100多个国家和地区的客户提供定制化、高品质、高性能的存储产品和解决方案。

（二）主要产品

公司的存储业务均系基于存储技术的研发与应用，以闪存主控芯片的设计、研发为差异化核心竞争力，结合固件方案及量产工具开发、存储模组测试和供应链管理等形成完善的存储解决方案，公司目前研发量产了多款存储主控芯片，最终通过存储模组产品形式实现销售。

在“聚焦存储”战略指导下，公司不断完善存储产品矩阵，拓展产品应用领域与应用场景，目前已经形成了包括固态硬盘、嵌入式存储、内存条和移动存储在内多条存储产品线。在消费级市场，公司通过自研主控、自建测试与生产线，形成具有较高性价比的标准化移动存储、固态硬盘、内存条等存储产品；在商规级、工规级、车规级与企业级应用领域，公司聚焦场景需求，灵活、高效调整主控与固件方案，为客户提供高品质、定制化的存储解决方案。

公司持续推动研发创新，产品矩阵快速拓展，具体情况如下：

1.固态硬盘

固态硬盘使用固态存储芯片阵列制成，它的出现满足了大容量存储应用场景需求，被广泛应用于PC、数据中心、人工智能、工控、安防、网络终端、医疗、航天、军工等诸多领域。

公司目前拥有2.5 inch、SATA、M.2、U.2等形态的SSD系列产品，除SATA接口外，M.2支持SATA3、PCIe两种协议接口。产品采用原厂提供的优质NAND Flash资源，结合定制化高性能主控和自主固件，在保证兼容性和稳定性的同时，也可实现各类客制化需求。

固态硬盘能够显著提升台式机、笔记本等个人和商用电脑的性能，在企业级、服务器系统和数据中心等应用领域更能展现其强大性能。AI浪潮下，公司正加快向高容量、高性能固态硬盘产品拓展，重点聚焦于QLC NAND应用与企业级SSD两大方向。针对前者，公司前瞻性地布局相关关键技术，包括针对QLC NAND介质特性开发的新一代纠错算法、压缩技术、低功耗设计等，且公司新一代主控均高效支持QLC NAND，实现QLC产品在传输速度、耐用性上有效提升。目前，公司已经具备了成熟的QLC NAND商业应用能力，并已经实现量产销售。企业级SSD方面，公司依托优秀的企业级研发和测试团队，通过系统的硬件工程设计、创新的固件算法优化、深度的介质应用挖掘等方式，在满足产品性能、可靠性、QoS等指标的同时，持续为客户提供增值特性服务。面对国产化趋势，公司将发挥技术优势，加快国产化平台认证导入进程，助力SSD国产化进程。

报告期内，公司面向高性能应用领域，推出了M.2 2280 NVMe PCIe 5.0 x4 SSD，顺序读写性能达到14100/12200MB/s，容量规格设定为1TB-8TB，显著降低数据传输的延迟，内置智能电源管理模块，确保在高性能运行的同时保持低功耗和高稳定性，广泛支持AI+技术，满足大数据、云计算和高性能计算的存储需求。公司正在加快推进产品研发与客户验证工作，目前已给多家云服务企业进行送样，部分产品已顺利通过客户验证并成功导入。

报告期内，搭载公司自研SATA SSD主控芯片的固态硬盘模组产品完成了初步调试工作，正在加快产品导入与客户导入工作。公司同步推进搭载该自研主控的工规级SSD产品开发，并已全面推向市场。在工规级固态硬盘产品矩阵构建上，公司形成了覆盖SATA III、PCIe 3.0/4.0等主流接口，以及2.5寸、mSATA、M.2等多元形态的全场景产品布局，可适配工控机、服务器、嵌入式设备等多样化硬件平台，实现从32GB到8TB的全容量段覆盖，满足不同工业场景的存储容量需求。

面对智能制造、智慧交通、能源电力、网络通信等战略领域的高价值工控市场，公司聚焦工业级存储的严苛要求，推出定制化行业解决方案。该方案以“主控芯片+固件算法+定制服务”的全栈技术架构为核心，在具备宽温、抗硫化、防尘、抗冲击、抗压等工业级核心性能指标的基础上，针对细分场景需求提供差异化技术支持：例如为边缘计算设备定制低延迟、高耐久的存储方案，确保数据实时处理的响应速度与长期寿命；为5G基站、电力监控设备开发抗电磁干扰、长寿命的存储方案，保障复杂电磁环境下的稳定运行。通过深度理解工业客户在可靠性、稳定性与定制化方面的核心诉求，公司构建了从单一硬件到系统级的全链条解决方案能力，形成技术壁垒鲜明的市场竞争力。

报告期内，公司高速PCIe固态硬盘销售规模同比提升979%，2TB以上高容量固态硬盘销售规模快速提升，面对AI浪潮，公司正在布局更高端的PCIe SSD存储解决方案，在接口速度、性能优化、数据分层、纠错能力与寿命管理等方面持续优化。

2.嵌入式存储

嵌入式存储广泛应用于智能终端，如智能手机、平板、智能电视、机顶盒等，近年随着智能网联汽车蓬勃发展，自动驾驶辅助系统（ADAS）、智能车载娱乐系统（IVI）、行车记录仪（DASH-CAM）、增强现实/虚拟现实设备、人工智能边缘计算等设备也成为嵌入式存储的主战场。

公司目前嵌入式存储产品线已经布局车规、工规、商规，并开发了高耐久特性产品。面向差异化市场，采用包括eMMC 5.1在内的主流协议标准，以丰富的闪存及主控方案搭配，深入分析应用场景需求，以实现市场成本与性能的均衡匹配，针对高速、大容量的应用，特别是端侧AI应用场景，公司推出了多款LPDDR、UFS产品并不断优化创新。

报告期内，公司eMMC存储产品通过主流5G通讯方案商紫光展锐新一代芯片移动平台的产品认证许可，可应用于其主流5G生态系统的高端存储芯片，在5G智能终端、物联网领域应用中取得重大的市场拓展。同时，公司新拓展了LPDDR产品线，规划覆盖了LPDDR4X、LPDDR5系列规格产品线体系，其中LPDDR4X已经具备量产能力并有产品样品用于客户送样。公司也在积极推动自研嵌入式存储主控，助力嵌入式存储产品的国产化进程和自主可控水平，为我国的数据信息安全贡献力量。

公司2023年以来持续加强嵌入式存储研发与业务团队建设，并加快消费电子与工控领域的拓展。在消费电子领域，公司通过完善的供应链管理，确保稳定供应的同时，为客户提供产品全生命周期服务；在工业级存储领域，公司产品矩阵已经涵盖eMMC、UFS、LPDDR等核心品类，针对工业应用的严苛环境特性，同样完成了宽温域适应性、抗硫化设计、定制化固件优化等关键技术升级，确保在电力设施、网络安全设备、数据通信设备等高可靠性要求场景下实现7×24小时稳定运行。产品设计充分考虑工业级应用的复杂性，通过优化存储颗粒控制算法与硬件电路布局，有效提升数据读写的一致性与抗干扰能力，满足工业终端设备在高温、高湿、强振动等极端条件下的长期可靠存储需求。

3.内存条

内存条广泛应用于个人电脑、服务器、工作站、商用终端等设备，随着人工智能、云计算和大数据技术的快速发展，个人电脑、数据中心和云服务器对高速、大容量内存的需求日益增长。

公司目前已经组建了内存条产品线相关团队，并规划了覆盖DDR3、DDR4及DDR5系列规格，主要类型分为LPCAMM2、CAMM2、RDIMM、SODIMM和UDIMM等。为快速实现高质量产品的批量交付，公司内存业务与研发团队在高效完成产品设计与方案开发的同时，着手研发并部署了内存产品测试设备，保障产品可靠性与兼容性，依托现有客户资源实现市场快速突破。针对AI应用与工控场景，研发团队不仅在硬件设计上改进散热设计、添加电源管理系统，快速跟进新型外型尺寸与接口，更基于自研固件技术实现数据加密、错误校正码、温度管理、自适应电压调节、数据完整性保护、动态频率调整等功能。公司内存产品线已经依托自主研发的固件算法优化与硬件协同设计能力，形成从芯片选型到终端适配的全栈技术闭环，未来将持续拓展LPCAMM2等新品，强化存储性能与服务质量（QoS）保障。

报告期内，公司消费级内存已经开始量产出货，并加快行业客户、品牌终端客户产品送样与验证工作。同时，公司最新推出了包括SO-DIMM、U-DIMM、RDIMM、CSODIMM、CUDIMM和LPCAMM2、CAMM2等系列内存模组产品，兼容主流CPU平台与操作系统，并配套了全流程自动化测试量产工具，为应对复杂计算挑战提供高效稳定的人工智能存储方案。

4.移动存储

移动存储作为传统存储类型，因其技术成熟且具有低功耗、低成本等特点，在数据备份、文件传输、移动终端等场景大量应用。而随着存储原厂晶圆制造技术快速迭代，存储密度不断提高，移动存储也迎来更多应用场景落地机会，特别是在视频监控、工业控制等不断增长的细分领域。为针对不间断录制环境下高写入存储需求，公司新一代SD卡主控芯片采用创新架构设计，支持144/176层乃至更高层的3D TLC/QLC NAND，支持4K LDPC技术与ONFI 4.0协议，通过优化的固件方案与智能算法，实现写放大比降低和动态磨损平衡，提升产品兼容性与耐久性，该芯片还内置了S.M.A.R.T健康监测系统，采用低功耗设计，支持生产环境下的预测性维护与能耗管理，全面满足工业级存储的可靠性与能效要求。

1）存储卡模组

存储卡是一种利用闪存技术存储数据信息的存储器，其尺寸小巧，外形多为卡片形式，主要应用于手机、GPS设备、数码相机、无人机、安防摄像头、智能音箱、电子游戏机等消费电子产品中作为存储介质。此外，公司进一步开发了工规级、商规级存储卡产品，及产品具有宽温和高耐久特性，可适用于车载监控、行车记录仪、中控导航、灾备盒、部标机等对产品稳定性要求较高的复杂环境。

公司存储解决方案广泛支持长江存储、三星电子、海力士、美光等各家存储原厂的相关存储晶圆产品，并高效实现对NAND Flash存储颗粒的数据管理和应用性能提升，进一步扩展存储卡模组产品的兼容性、提高存储卡的读写速度、稳定性以及降低整机产品功耗等。

报告期内，搭载公司新一代自研SD6.0存储卡主控芯片的存储模组已经完成产品开发，目前客户送样和产品验证工作进展顺利，公司未来将加快实现搭载自研主控存储模组的客户导入与批量出货。

2）存储盘模组

存储盘（U盘）是一种通过USB接口进行数据传输，利用NAND Flash存储芯片进行存储的可移动数据存储装置，目前已经成为人们日常生活中最常用的移动存储介质之一。公司存储盘模组产品方案具有较好的性能和成本优势以及广泛地支持三星电子、铠侠、西部数据、海力士、长江存储等各家存储原厂的相关存储晶圆产品。

报告期内，公司推出USB/Type-C双头高速存储盘产品USSD，采用最新SSD级别主控芯片，最高读写速度超过1000MB/s，可以直连电脑主板、迷你机电脑、笔记本电脑、平板电脑和手机等电子设备，满足高速、高容、便捷移动的存储需求。报告期内，公司加快了移动存储产品的车规级、工规级产品应用，在车载电子、行车记录仪、工控设备等领域实现了规模销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	6,568,159,107.56	3,288,196,110.77	99.75%	1,996,923,410.99
归属于上市公司股东的净资产	2,480,378,428.99	1,122,034,573.15	121.06%	1,092,783,567.60
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	4,772,546,275.05	1,775,912,799.26	168.74%	1,190,656,505.59
归属于上市公司股东的净利润	350,553,740.48	24,998,465.34	1,302.30%	67,499,910.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	302,698,112.09	14,936,707.92	1,926.54%	11,792,427.78
经营活动产生的现金流量净额	−1,263,366,719.31	−1,015,413,532.56	−24.42%	−330,737,128.81
基本每股收益（元/股）	2.38	0.17	1,300.00%	0.53
稀释每股收益（元/股）	2.35	0.17	1,282.35%	0.53
加权平均净资产收益率	26.83%	2.26%	24.57%	8.28%

注：2022年、2023年基本每股收益、稀释每股收益已按照除权后的股本重新计算。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	810,869,692.86	1,365,218,542.97	1,420,913,652.37	1,175,544,386.85
归属于上市公司股东的净利润	195,492,337.08	192,154,813.39	34,058,504.26	−71,151,914.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	192,554,241.90	177,421,438.27	32,309,775.75	−99,587,343.83
经营活动产生的现金流量净额	−82,072,765.52	−577,778,106.73	−280,132,149.22	−323,383,697.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,333	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	26,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李虎	境内自然人	39.26%	58,401,775	58,401,775	质押	16,880,000	
魏宏章	境外自然人	5.82%	8,661,755	0	质押	3,500,000	
淮安金程源企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.45%	8,107,043	0	不适用	0	
徐倍群	境内自然人	4.41%	6,556,059	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.94%	1,391,760	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司－易方达战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.80%	1,197,212	0	不适用	0	
LEADINGUI CO., LTD.	境外法人	0.78%	1,161,442	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	1,049,457	0	不适用	0	
#上海姚泾河私募基金管理有限公司－姚泾河瑞麟私募证券投资基金	其他	0.67%	995,900	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.63%	936,268	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海姚泾河私募基金管理有限公司－姚泾河瑞麟私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份995,900股；洪海伶通过普通证券账户持有公司股份4,500股，通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份907,260股，实际合计持有911,760股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

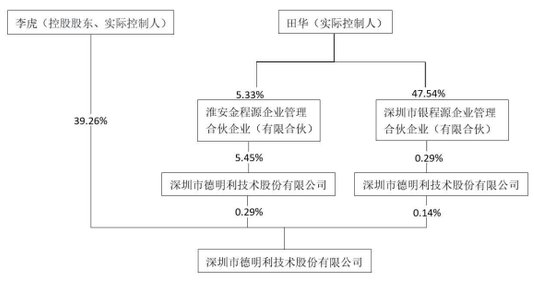
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至2024年12月31日）



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目

公司于2022年8月4日召开第一届董事会第二十二次会议、于2022年8月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟租赁新物业投资建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目的议案》，同意公司租赁深圳市福田区八卦岭八卦四路中厨6号综合厂房第1-7层用于建设智能制造（福田）存储产品产业基地项目，具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2023年，公司福田分公司已由原地址深圳市龙华区大浪街道浪口社区华霆路387号1栋3层、4层、5层整体搬迁至新地址深圳市福田区园岭街道上林社区八卦四路14号中厨6号综合厂房101第1-7层。目前主体装修及安装工程已经完成，项目已完成竣工验收，并已经正式投入运营，贯穿原材料检验、测试、SMT、封装等多环节；新增扩产生产及测试设备在陆续交付、安装过程中。目前项目已先后取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、智能制造成熟度（CMMM）三级评估、通过IECQ QC080000有害物质过程管理体系认证、BSCI社会责任体系认证、ESD静电防护管理体系认证，用卓越的品质提升客户满意度，实现企业可持续发展。

2、向特定对象发行股票并在主板上市

公司于2023年6月29日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、于2023年7月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司于2024年1月15日公司召开第二届董事会第十三会议和第二届监事会第十二会议，对以上文件进行了修订，并按露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件；2024年6月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，及于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》等相关议案；2024年6月27日，公司召开第二届董事会第十八会议和第二届监事会第十七会议，对相关文件再次进行了二次修订，并按露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关文件；2024年8月6日，公司公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九会议，对相关文件再次进行了三次修订，并按露了《深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》等相关文件。

2024年10月10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市德明利技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2024年11月15日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1608号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，后续公司将在12个月内严格按照报送深交所的申报文件和发行方案实施本次发行。

2024年12月24日，公司2023年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件经深交所备案通过。

2025年1月23日，公司完成向特定对象发行股票登记并上市的工作。

3、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项

公司于2024年4月28日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，决定对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目结项，并将节余募集资金522.90万元（全部为累计收到的银行存款及理财产品利息扣除银行手续费等的净额，具体金额以资金划转日专户余额为准），用于永久补充流动资金，同时注销相关的募集资金专户。

4、设立北京分公司

公司于2024年3月15日成立深圳市德明利技术股份有限公司北京分公司，北京分公司统一社会信用代码为91110108MADDKNUL72，地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼5层101，负责人陶立平，一般经营范围项目为：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5、设立杭州分公司

公司于2024年7月9日成立深圳市德明利技术股份有限公司杭州分公司，杭州分公司统一社会信用代码为91330108MADP53FT1B，地址为浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨文路868号闻涛新生大厦1幢10层1001室，负责人陶立平，一般经营范围项目为：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；数据处理和存储支持服务；集成电路销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、设立长沙分公司

公司于2024年11月13日成立深圳市德明利技术股份有限公司长沙分公司，长沙分公司统一社会信用代码为91430104MAF5L7YU2A，地址为湖南湘江新区麓谷街道尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期总部大楼606室，负责人陶立平，一般经营范围项目为：一般项目：信息系统集成服务；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；货物进出口；进出口代理；技术进出口；数据处理和存储支持服务；凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、2023年度权益分派

公司于2024年3月18日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，于发布了《2023年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2024-030），以截至2023年12月31日的公司总股本113,247,800为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元，不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，本次权益分派股权登记日为2024年4月25日，除权除息日为2024年4月26日。2024年4月26日，本次权益分派实施完毕。

8、公司章程与注册资本的变更

（1）公司于2024年6月11日召开第二届董事会第十七次会议、于2024年6月27日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》等议案，公司于2024年7月2日完成《公司章程》的修改和公司注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为147,512,976元。

（2）2024年6月20日，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共73,255股，公司注册资本由原人民币147,512,976元变更为人民币147,586,231元。

2024年10月14日，公司2024年股权激励计划首次授予股份完成登记上市，本次登记上市股份数共1,114,700股，公司注册资本由原人民币147,586,231元变更为人民币148,700,931元。

2024年11月21日，公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权股票完成登记上市，本次登记上市股份数共43,953股，公司注册资本由原人民币148,700,931元变更为人民币148,744,884元。

2024年11月27日，公司回购注销2023年股权激励计划不符合激励条件的1名离职人员已授予登记的限制性股票1,820股。本次回购注销完成后，公司注册资本由原人民币148,744,884元变更为人民币148,743,064元。

公司向特定对象发行股票新增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记，并于2025年1月23日上市。本次登记上市股份数共13,029,608股，本次发行新增股票登记上市后，公司注册资本将由原人民币148,743,064元变更为人民币161,772,672元。

公司于2025年1月21日召开了第二届董事会第二十六次会议、2025年2月14日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司已根据上述变更事项，及时向深圳市工商登记管理部门办理相应的工商登记变更手续。上述变更事项最终以深圳市工商登记管理部门登记的内容为准。

9、证券投资

报告期内，公司参与联芸科技（杭州）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的战略配套，发行价格为11.25元/股，公司认购680,851股，缴款金额7,659,573.75元。联芸科技股票已于2024年11月29日于科创板上市，公司所认购的股票自联芸科技股票上市之日起限售12个月。

10、通过海关AEO高级认证企业资质认证

公司于2025年1月取得深圳海关颁发的AEO高级认证企业证书。AEO认证是中国海关对企业信用管理的最高等级认证，被誉为开展国际贸易的“金字招牌”，AEO企业可享受互认国家双方海关的“国际最认可、国内最优惠、通关最便利”等多维度优惠措施，公司全球通关效率再提速。公司将以通过AEO认证为契机，依托高效的内控体系，提升风险管控能力与运营效率，提升国际物流效率，优化供应链体系，为全球客户提供了更高效、更可靠的全球交付服务。

11、向金融机构申请综合授信及接受关联方担保

（1）2022年08月29日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为HTZ442008040QTLX2022N029号的《综合融资额度合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（2）2023年01月10日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2023固字01号的《固定资产贷款合同》，授信总额度为16,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为8,696.63万元。

（3）2023年04月25日，公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订了编号为07300LK23C5AM-DC号的《线上流动资金贷款总协议》，授信额度为15,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎提供连带责任保证担保，截止2024年2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（4）2023年06月16日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为81200202300003589号的《最高额综合授信合同》，授信额度为8,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（5）2023年06月19日，公司与东莞银行股份有限公司深圳分行签订了编号为东银（0019）2023年额度贷字第046336号的《循环额度贷款合同》，授信额度为15,000.00万元，此笔授信由公司控股股东李虎提供连带责任保证担保，控股股东配偶田华为此出具了承诺函，承诺同意李虎为此笔授信提供连带责任保证担保并愿与李虎共同按照最高额保证合同/保证合同等相关法律文件的约定履行合同义务，对相关债务承担连带保证责任，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（6）2023年06月21日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了编号为2023圳中银华额协字第0093号的《授信额度协议》，授信额度为11,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（7）2023年06月25日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（584900）浙商银综授字（2023）第00009号的《综合授信协议》，授信额度为10,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（8）2023年07月24日，公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了编号为SZ36（融资）20230008号的《最高额融资合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（9）2023年07月26日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支行签订了编号为PS-BCSZ05-YYT2023072601号的《流动资金借款合同》，授信额度为5,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（10）2023年08月02日，公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了编号为（2023）深银综授额字第001014号的《授信额度合同》，授信额度为9,400.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（11）2023年08月14日，公司与深圳市中小担小额贷款有限公司签订了编号为深中小贷（2023）年借字（0287）号的《借款合同》，借款额度为5,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，深圳市深担增信融资担保有限公司为公司此笔授信提供保证担保，此外公司质押了以下5个发明专利：①一种命令超时处理方法及系统（专利号为ZL201810603200.4）、②基于爬山算法的触控屏抗干扰方法、触控装置及移动终端（专利号为ZL201811087120.4）、③一种数据存储方法及存储器（专利号为ZL201811123529.7）、④一种基于区域镜像的角落触控识别方法、装置及移动终端（专利号为ZL201811512838.3）、⑤一种用于大尺寸触摸屏的触摸屏传感器及触摸识别方法（专利号为ZL201910414038.6），截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（12）2023年08月17日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了编号为BC20230803000001397号的《融资额度协议》，授信额度为15,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（13）2023年08月23日，公司与中国进出口银行深圳分行签订了编号为HET02020000162023080000019号的《借款合同》，编号为深字2023年贸金025号的《贸易金融授信业务总协议》，授信总额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（14）2023年09月20日，公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了编号为ZH39182309002号的《综合授信合同》，授信总额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为0万元。

（15）2023年12月28日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行签订了编号为SX2312223802号的《综合授信合同》，授信总额度为10,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为5,000.00万元。

（16）2024年03月21日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳福田支行签订了编号为81200202400021874号的《最高额综合授信合同》，授信额度为8,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为流贷2,550.00万，银承645.72万元。

（17）2024年03月22日，公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订了编号为交银深德明利2024综字01号的《综合授信合同》，授信总额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为17,800.00万元。

（18）2024年03月26日，公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了编号为兴银深中德明利授信字（2024）第001号的《额度授信合同》，授信额度为20,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带责任保证担保，截至2024年12月31日该笔授信借款余额为12,000.00万元。

（19）2024年04月26日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了编号为2024深银观澜综字第0004号的《综合授信合同》，授信额度为30,000.00万元，此笔授信由公司实际控制人李虎、田华提供连带